(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

G00001

(43) 国際公開日
2003年1月30日 (30.01.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/009657 A1

(51) 国際特許分類7: H05K 3/00

(21) 国際出願番号: PCT/JP02/07242

(22) 国際出願日: 2002年7月17日 (17.07.2002)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2001-219295 2001年7月19日 (19.07.2001) JP
特願2002-27763 2002年2月5日 (05.02.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒103-8666 東京都 中央区 日本橋室町2丁目2番1号 Tokyo (JP)

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 赤松 孝義 (AKAMATSU,Takayoshi) [JP/JP]; 〒520-0837 滋賀県 大津市 中庄1丁目14-17-1110 Shiga (JP) 奥山 太 (OKUYAMA,Futoshi) [JP/JP]; 〒520-0842 滋賀県 大津市 園山2丁目10番B4-44 Shiga (JP). 黒木 信幸 (KUROKI,Nobuyuki) [JP/JP]; 〒520-0845 滋賀県 大津市 若葉台28番21号 Shiga (JP) 榎本 裕 (ENOMOTO,Hiroshi) [JP/JP]; 〒411-0033 静岡県 三島市 文教町2丁目12番3号B46 Shizuoka (JP). 林 徹也 (HAYASHI,Tetsuya) [JP/JP]; 〒520-0842 滋賀県 大津市 園山2丁目13番1号 Shiga (JP). 松田 良夫 (MATSUDA,Yoshio) [JP/JP]; 〒520-3201 滋賀県 甲賀郡 甲西町下田920-97 Shiga (JP) 榛葉 陽一 (SHINBA,Yoichi) [JP/JP]; 〒520-0842 滋賀県 大津市 園山2丁目10番A3-33 Shiga (JP). 小國 昌宏 (OGUNI,Masahiro) [JP/JP]; 〒458-0044 愛知県 名古屋市 緑区池上台1丁目82番A棟1-3号室 Aichi (JP)

(74) 代理人: 佐藤 謙二 (SATO,Kenji); 〒520-8558 滋賀県 大津市 園山1丁目1番1号 株式会社東レアイ・ピー・イー 滋賀支所内 Shiga (JP).

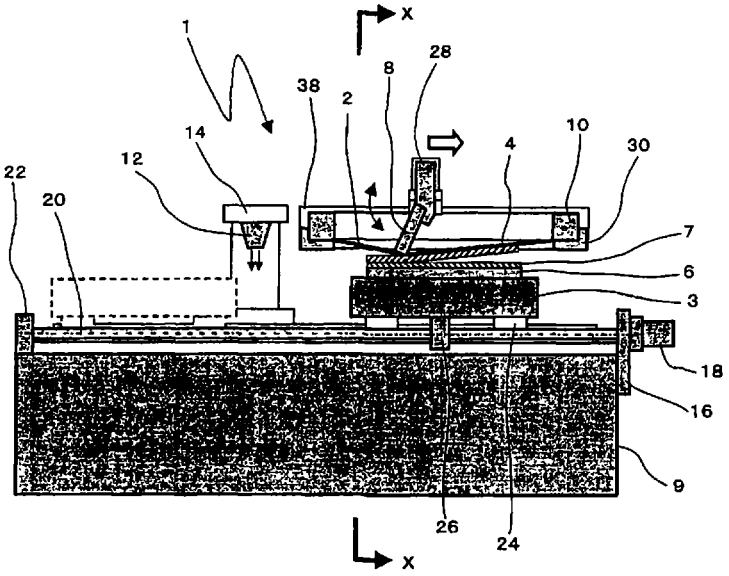
(81) 指定国 (国内): CN, KR, SG, US.

[続葉有]

(54) Title: CIRCUIT BOARD, CIRCUIT BOARD-USE MEMBER AND PRODUCTION METHOD THEREFOR AND METHOD LAMINATING FEXIBLE FILM

(54) 発明の名称: 回路基板, 回路基板用部材及びその製造方法並びに可撓性フィルムのラミネート方法

162162



(57) Abstract: A circuit board using a flexible film having high-precision patterns, a circuit board-use member, and a production method for a circuit board-use member excellent in productivity A circuit board comprising metal circuit patterns provided on a flexible film, the positional precision of the circuit patterns being up to ± 0.01%. A circuit board-use member comprising, laminated in the order mentioned, a circuit board reinforcing sheet (6), a releasable organic matter layer (7), a flexible film (4), and metal circuit patterns.

[続葉有]

WO 03/009657 A1

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE. DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR)

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:
— 国際調査報告書

(57) 要約:

本発明は、高精度な回路パターンを有する可撓性フィルムを用いた回路基板、回路基板用部材と生産性に優れた回路基板用部材の製造方法に関する。

本発明は、可撓性フィルムに金属からなる回路パターンが設けられた回路基板であって、回路パターンの位置精度が±０．０１％以下である。

また、本発明は、回路基板補強板（６）、剥離可能な有機物層（７）、可撓性フィルム（４）、金属からなる回路パターンの順に積層された回路基板用部材である。